

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于士兰集科 12 吋芯片生产线投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、投资概述

（一）杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）于 2017 年 12 月 18 日在中国厦门共同签署了《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），双方在厦门市海沧区规划建设两条 12 吋集成电路制造生产线（以下简称：12 吋线），第一条 12 吋线总投资 70 亿元，其中一期总投资 50 亿元，实现月产能 4 万片；二期总投资 20 亿元，新增月产能 4 万片。

根据《投资合作协议》，双方在厦门市海沧区共同投资成立了厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”），双方合计向士兰集科出资 20 亿元，其中：厦门半导体出资 17 亿元，本公司出资 3 亿元。

上述事项详见公司于 2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 12 日和 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告，公告编号为临 2017-067、临 2018-001 和临 2018-010。

（二）公司于 2019 年 11 月 8 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》：本公司与厦门半导体按股权比例，以货币方式同比例认缴士兰集科新增的全部注册资本 50,049 万元，其中：本公司认缴 7,507.35 万元；厦门半导体认缴 42,541.65 万元。增资完成后，士兰集科的注册资本由 200,000 万元增加为 250,049 万元。

上述事项详见公司于 2019 年 11 月 9 日披露的相关公告，公告编号为临 2019-047。

（三）根据《投资合作协议》，士兰集科于 2021 年上半年启动了第一条 12

吋芯片生产线二期之“新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”，该项目总投资为 20 亿元，实施周期为 2 年。

上述事项详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的相关公告，公告编号：临 2021-023。

（四）公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》：本公司和厦门半导体按股权比例，以货币方式同比例认缴士兰集科新增的全部注册资本 50,000 万元，其中：本公司认缴 7,500 万元；厦门半导体认缴 42,500 万元。增资完成后，士兰集科的注册资本由 250,049 万元增加为 300,049 万元。

上述事项详见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的相关公告，公告编号：临 2021-029。

（五）公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》：本公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）以货币方式共同出资 885,000,000 元认缴士兰集科新增的全部注册资本 827,463,681 元，其中：本公司出资 285,000,000 元认缴新增注册资本 266,471,355 元；大基金二期出资 600,000,000 元认缴新增注册资本 560,992,326 元。本次增资溢价部分计入士兰集科的资本公积。士兰集科另一方股东厦门半导体放弃优先认购权。本次增资完成后，士兰集科的注册资本将由 3,000,490,000 元增加为 3,827,953,681 元。本次交易需提交公司股东大会审议，并经大基金二期、厦门半导体和士兰集科等各方内部权力机构批准后方可正式实施。

本次增资完成前后，士兰集科的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	厦门半导体投资集团有限公司	255,041.65	85	255,041.65	66.626
2	杭州士兰微电子股份有限公司	45,007.35	15	71,654.4855	18.719
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	-	56,099.2326	14.655
合计		300,049.00	100	382,795.3681	100

（上述士兰集科认缴注册资本 300,049 万元已全部实缴到位。）

上述事项详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的相关公告，公告编号：临

2022-009。

## 二、投资事项的进展

公司于2022年3月9日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》（详见公司于2022年3月10日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2022-013）。

截至2021年底，士兰集科已实现一期项目月产4万片的产能建设目标，12月份芯片产出已达到3.6万片，2021年全年产出芯片超过20万片。目前，士兰集科12吋线产品包括沟槽栅低压MOS、沟槽分离栅SGT-MOS、高压超结MOS、TRENCH肖特基、IGBT、高压集成电路等。今后，随着二期项目建设进度加快，士兰集科12吋线工艺和产品平台还将进一步提升，公司将持续推动满足车规要求的功率芯片和电路在12吋线上量。

## 三、进展事项对上市公司的影响

本次增资事项完成后将进一步增加士兰集科的资本充足率，有利于加快12吋集成电路芯片生产线的建设和运营，积极推动士兰集科的产能提升，为本公司提供产能保障，对本公司的经营发展具有长期促进作用。

后续公司将根据投资进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022年3月10日